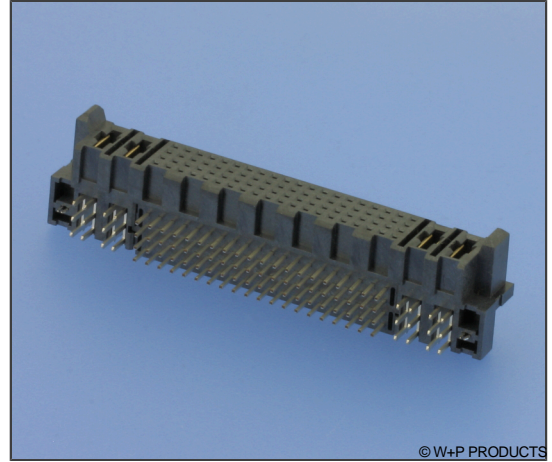


Power-Signal-Terminal RM 5,00/2,00mm, Buchsenkontakte, gewinkelt Power-Terminal 5.00mm Pitch, Female, Right-angled

Technische Daten / Technical Data

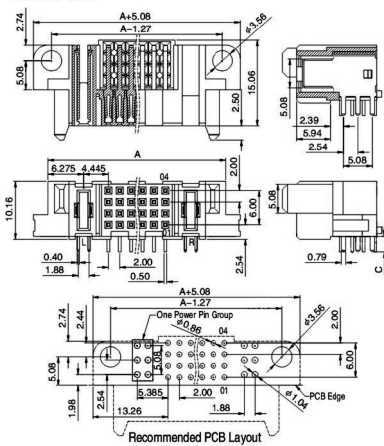
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	Power: 24,7 A / Signal: 1 A Power: 24.7 A / Signal: 1 A
Verarbeitung <i>Processing</i>	-55 °C ... +105 °C -55° ... +105 °C 260 °C für 10s 260 °C for 10s



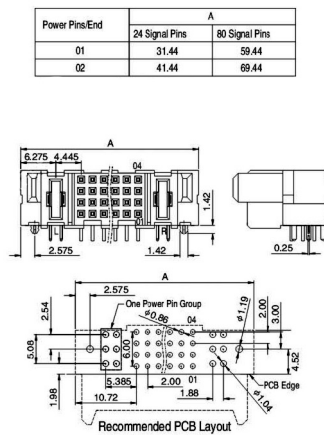
© W+P PRODUCTS

Gegenstecker / Mating Connectors :
455 (24/80), 457 (24/80)

W/Screw Down



W/Locking Clip



Power Pins/End	A	
	24 Signal Pins	80 Signal Pins
01	31.44	59.44
02	41.44	69.44

Series	Power C.*	Signal C.*	Power C.*	Terminals*	Plating P.C.*	Plating S.C.*	Loc. Opt.*	Packaging*
456	01	80	01	21	00	00	20	ST
	01/02 Contacts Left	24/80 Contacts	01/02 Contacts Right	20 C=2.72 21 C=3.52 22 C=4.32	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	20 Locking Clips 30 Screw down	ST TRAY

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes
TRAY Auf Tray / On tray

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

